

博通定制 AI 芯片部署规模有望继续增大 存储价格 Q2 反弹优于预期

——电子行业研究周报



申港证券
SHENGANG SECURITIES

投资摘要:

市场回顾

上周 (6.2-6.6) 申万电子行业指数上涨 3.60%，在申万 31 个行业中排名第 3，跑赢沪深 300 指数 2.72%。

每周一谈: 博通定制 AI 芯片部署规模有望继续增大 存储价格 Q2 反弹优于预期

博通发布季报，公司预计定制 AI 芯片的部署规模将在明年继续增大。根据澎湃新闻和半导体产业纵横消息，博通发布截至 2025 年 5 月 4 日的 2025 财年第二季度财报，该季度博通营收 150.04 亿美元，同比增长 20%，略高于市场预期的 149.9 亿美元。公司表示博通在第二季度实现了创纪录的营收，得益于 AI 半导体解决方案和虚拟化软件业务 VMware 的持续增长。第二季度 AI 营收同比增长 46% 至 44 亿美元以上，主要受益于对 AI 网络的强劲需求。公司预测第三季度营收约为 158 亿美元，同比增长 21%，略高于市场预期的平均数 157 亿美元。公司预计受其超大规模客户继续加大投资带动，AI 半导体收入将在第三季度加速增长至 51 亿美元，实现连续十个季度的增长。公司预计定制 AI 芯片的部署规模将在明年继续增大，相关营收有望远超公司前期预期。在 ASIC 市场，目前公司以 55%-60% 的份额位居第一。博通在 AI 芯片领域的核心优势在于定制化 ASIC 芯片和高速数据交换芯片，其解决方案广泛应用于数据中心、云计算、高性能计算和 5G 基础设施等领域。AI 以外的半导体销售复苏速度相对缓慢，公司预测第三季度非 AI 半导体收入将保持在 40 亿美元左右。

上半年存储价格整体呈现先跌后涨的走势，存储价格 Q2 反弹优于预期。根据集微网和 TrendForce 集邦消息，2025 年第一季度存储价格呈现下跌趋势，第二季度价格出现回升，上半年存储价格整体呈现“先跌后涨”的走势。2025 年第一季由于一般型 DRAM 合约价下跌，加上 HBM 出货规模收敛，DRAM 产业营收季减 5.5%，平均销售单价方面，多数产品合约价延续 2024 年第四季以来的跌势。TrendForce 集邦预计第二季度传统 DRAM 价格将反弹 3% 至 8%。

NAND Flash 合约价格方面，2025 年第一季度价格跌幅达到 15% 至 20%，为所有主要产品中跌幅最大的。第二季度，全球五大 NAND Flash 原厂三星、SK 海力士、美光、铠侠和西部数据同步实施减产，减产幅度在 10% 至 15% 之间，另外，贸易政策不确定性增加，市场加快备货，促使 2025 年第二季度存储价格，出现优于预期的反弹走势。

投资策略: 建议关注国产 AI 产业链相关标的海光信息、寒武纪-U、深南电路、华丰科技、杰华特、中科曙光、中兴通讯等；消费电子及端侧 AI 相关标的立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、歌尔股份、环旭电子、瑞芯微、兆易创新等；半导体设备和零部件、先进制程代工企业中芯国际、华虹半导体、北方华创、拓荆科技、精测电子等；建议关注有望受益存储上游控产、库存消化及行业供需关系改善逻辑下的存储模组和端侧存储公司。

风险提示: 贸易摩擦加剧，需求复苏不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧

评级

增持 (维持)

2025 年 06 月 09 日

王伟

分析师

SAC 执业证书编号: S1660524100001

行业基本资料

股票家数	461
行业平均市盈率	50.6
市场平均市盈率	12.6

行业表现走势图



资料来源: wind, 申港证券研究所

相关报告

1、《电子行业研究周报: 英伟达新品和互连技术发布 芯片国产替代加速》

2025-05-29

2、《电子行业研究周报: 美升级半导体出口管制 消费电子受益经贸关系缓和》

2025-05-21

3、《电子行业研究周报: 国产代工二季度指引谨慎不改长期受益趋势》2025-05-15

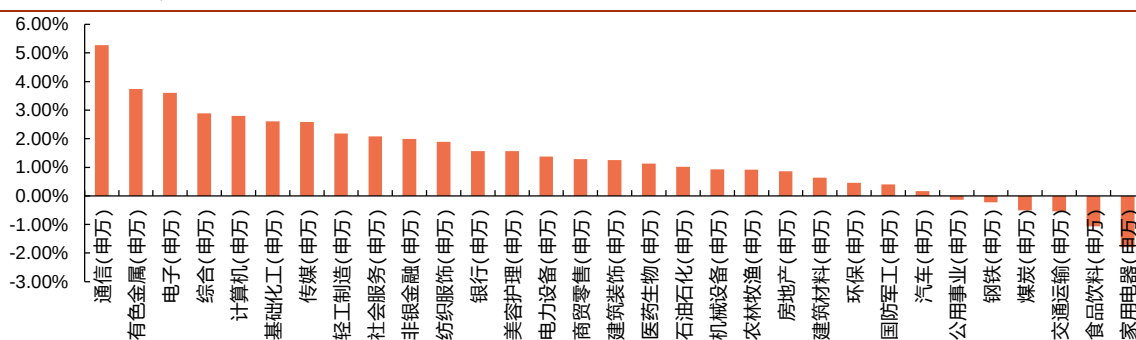
1. 市场回顾

上周(6.2-6.6)申万电子行业指数上涨 3.60%，在申万 31 个行业中排名第 3，跑赢沪深 300 指数 2.72%。

本月(6.1-6.6)申万电子行业指数上涨 3.60%，在申万 31 个行业中排名第 3，跑赢沪深 300 指数 2.72%。

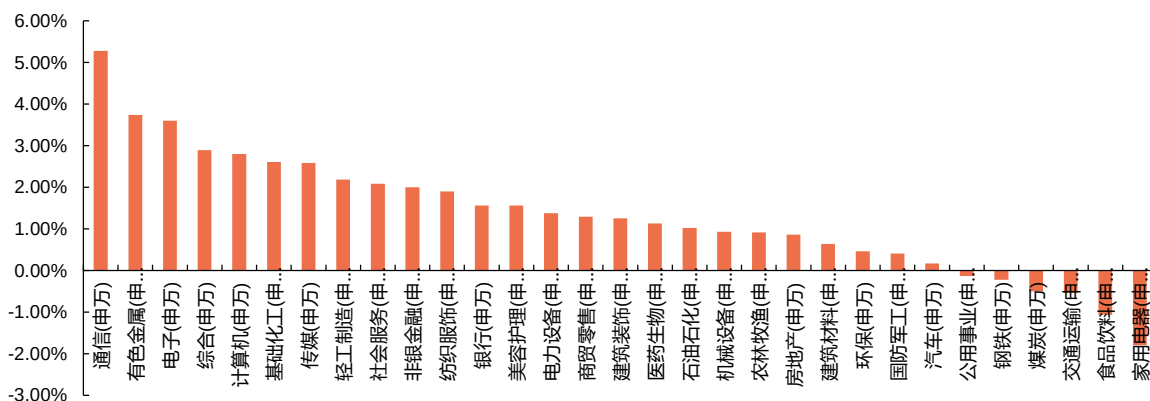
年初至今(1.1-6.6)申万电子行业指数下跌 1.02%，在申万 31 个行业中排名第 22，跑赢沪深 300 指数 0.53%。

图1：申万一级行业上周涨跌幅



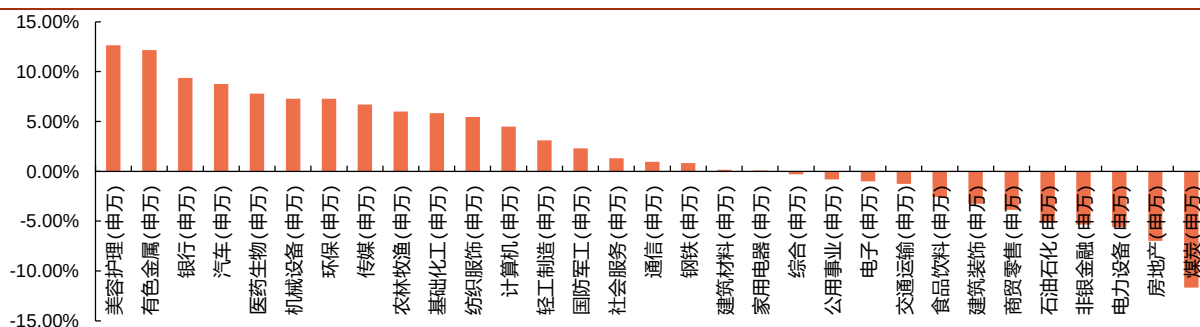
资料来源：wind，申港证券研究所

图2：申万一级行业本月以来涨跌幅



资料来源：wind，申港证券研究所

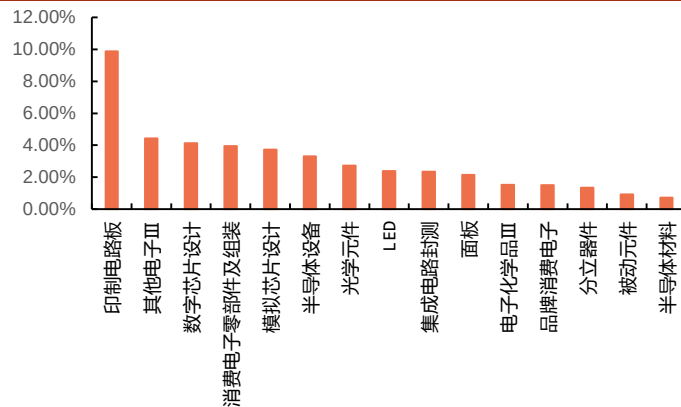
图3：申万一级行业年初至今涨跌幅



资料来源：wind，申港证券研究所

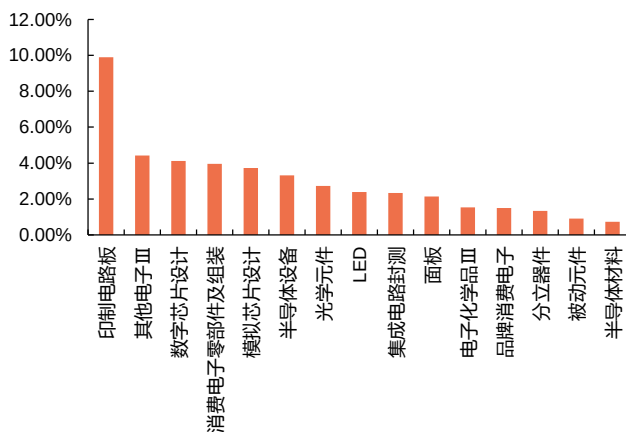
上周(6.2-6.6)申万电子行业三级子行业中印制电路板、其他电子III、数字芯片设计、消费电子零部件及组装、模拟芯片设计指数涨跌表现较好,分别跑赢沪深300指数9.01%、3.55%、3.25%、3.07%、2.85%。

图4: 电子子行业上周涨跌幅



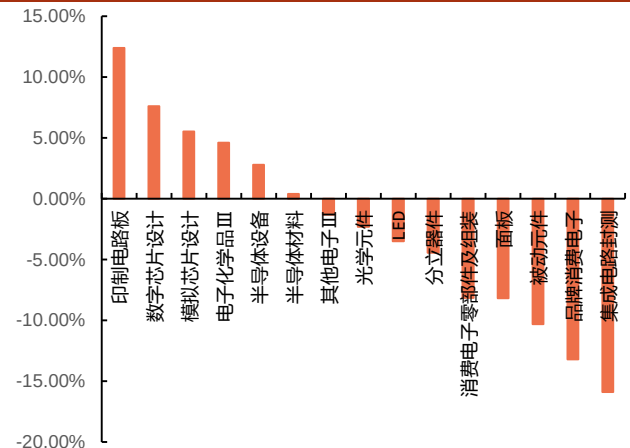
资料来源: wind, 申港证券研究所

图5: 电子子行业本月涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

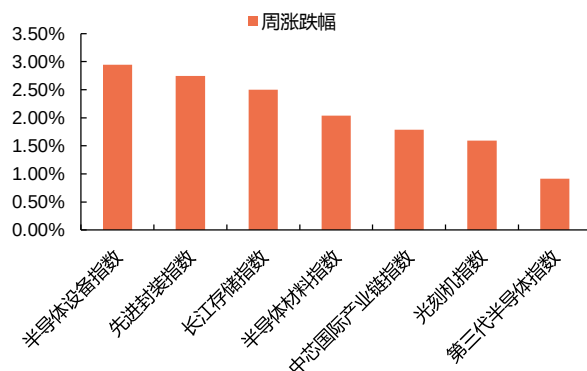
图6: 电子子行业年初至今涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

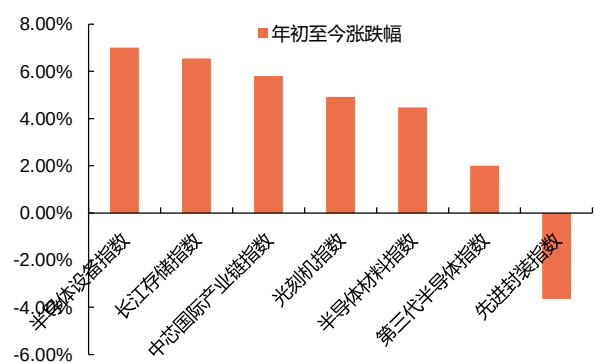
上周(6.2-6.6)万得半导体概念指数中半导体设备指数、先进封装指数、长江存储指数、半导体材料指数、中芯国际产业链指数、光刻机指数、第三代半导体指数涨跌幅分别为2.95%、2.74%、2.50%、2.04%、1.79%、1.59%、0.91%。

图7: 万得半导体概念指数上周涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

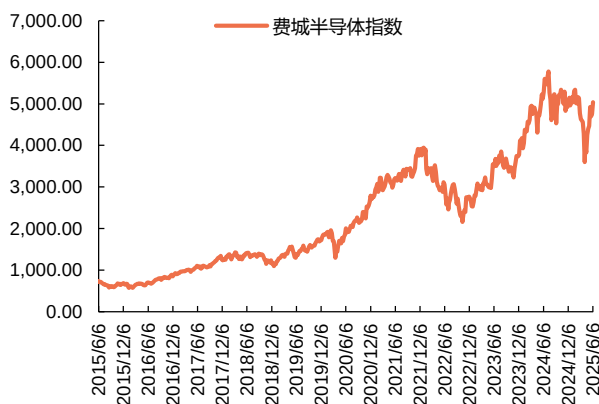
图8: 万得半导体概念指数年初至今涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

截至 6 月 6 日，费城半导体指数收于 5038.06 点、周上涨 5.9%。台湾半导体指数收于 605.78 点、周上涨 2.5%。

图9：费城半导体指数



资料来源：wind，申港证券研究所

图10：台湾半导体指数



资料来源：wind，申港证券研究所

2. 每周一谈：博通定制 AI 芯片部署规模有望继续增大 存储价格 Q2 反弹优于预期

博通发布季报，公司预计定制 AI 芯片的部署规模将在明年继续增大。根据澎湃新闻和半导体产业纵横消息，博通发布截至 2025 年 5 月 4 日的 2025 财年第二季度财报，该季度博通营收 150.04 亿美元，同比增长 20%，略高于市场预期的 149.9 亿美元。公司表示博通在第二季度实现了创纪录的营收，得益于 AI 半导体解决方案和虚拟化软件业务 VMware 的持续增长。第二季度 AI 营收同比增长 46%至 44 亿美元以上，主要受益于对 AI 网络的强劲需求。公司预测第三季度营收约为 158 亿美元，同比增长 21%，略高于市场预期的平均数 157 亿美元。公司预计受其超大规模客户继续加大投资带动，AI 半导体收入将在第三季度加速增长至 51 亿美元，实现连续十个季度的增长。公司预计定制 AI 芯片的部署规模将在明年继续增大，相关营收有望远超公司前期预期。在 ASIC 市场，目前公司以 55%-60%的份额位居第一。博通在 AI 芯片领域的核心优势在于定制化 ASIC 芯片和高速数据交换芯片，其解决方案广泛应用于数据中心、云计算、高性能计算和 5G 基础设施等领域。AI 以外的半导体销售复苏速度相对缓慢，公司预测第三季度非 AI 半导体收入将保持在 40 亿美元左右。

上半年存储价格整体呈现先跌后涨的走势，存储价格 Q2 反弹优于预期。根据集微网和 TrendForce 集邦消息，2025 年第一季度存储价格呈现下跌趋势，第二季度价格出现回升，上半年存储价格整体呈现“先跌后涨”的走势。2025 年第一季由于一般型 DRAM 合约价下跌，加上 HBM 出货规模收敛，DRAM 产业营收季减 5.5%，平均销售单价方面，多数产品合约价延续 2024 年第四季以来的跌势。TrendForce 集邦预计第二季度传统 DRAM 价格将反弹 3%至 8%。

NAND Flash 合约价格方面，2025 年第一季度价格跌幅达到 15%至 20%，为所有主要产品中跌幅最大的。第二季度，全球五大 NAND Flash 原厂三星、SK 海力士、美光、铠侠和西部数据同步实施减产，减产幅度在 10%至 15%之间，另外，贸易政策不确定性增加，市场加快备货，促使 2025 年第二季度存储价格，出现优于预期的反弹走势。

3. 重要公告

盛美上海：6 月 7 日发布关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。公司于 2025 年 6 月 6 日收到上海证券交易所出具的《关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体意见如下：“盛美半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

中芯国际：6 月 6 日发布关于全资子公司出售参股公司股权的公告。公司全资子公司中芯国际控股有限公司拟向湖南国科微电子股份有限公司出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司 14.832%的股权。本次交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股权。

聚辰股份：6 月 4 日发布股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动比例触及 1%整数倍且持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告。本次询价转让的价格为 63.19 元/股，转让的股票数量为 3,800,000 股。本次询价转让完成后，宁波亦鼎创业投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 7,620,906 股股份，占公司总股本的比例由 8.09%减少至 4.82%，累计权益变动比例触及 1%的整数倍且其所持有的公司权益比例已降至 5%以下。

4. 行业动态

2025Q1 全球半导体设备市场：中国大陆销售额下滑 18%，但仍以 32%份额居第一

6 月 9 日消息，国际半导体产业协会（SEMI）、日本半导体制造装置协会（SEAJ）最新公布的统计数据显示，今年一季度全球半导体制造设备销售额创下了历史次高记录，增长幅度也达到了 13 个季度以来最大增幅，但是中国大陆市场销售额大跌，而中国台湾市场销售额则同比大涨 200%。具体来说，今年一季度全球半导体设备销售额较同比大涨 21%至 320.5 亿美元，为连续第四个季呈现增长，增幅连续第三个季度达 2 位数百分比（10%以上）、创 13 个季度以来（2021 年 10-12 月当季以来、暴增 41%）最大增幅，季度销售额创有数据可供比较的 2005 年以来历史次高

纪录（仅低于 2024 年 10-12 月的 335.6 亿美元）。

从区域销售额变化来看，一季度中国大陆市场销售额同比大跌 18%至 102.6 亿美元，连续第 8 个季度成为全球最大芯片设备市场。不过因中国台湾、韩国半导体设备投资增加，中国大陆占整体半导体设备销售额比重自去年同期的 47%萎缩至 32%；韩国市场销售额暴增 48%至 76.9 亿美元，连续第二季超越中国台湾，成为全球第二大半导体设备市场；中国台湾市场销售额则同比暴涨 203%至 70.9 亿美元；北美市场销售额暴增 55%至 29.3 亿美元；日本市场销售额大增 20%至 21.8 亿美元；欧洲市场销售额则暴跌 54%至 8.7 亿美元。（来源：芯智讯）

博通 Q2 营收 150 亿美元创历史新高，AI 芯片收入超 44 亿美元

当地时间 6 月 5 日，芯片大厂博通（Broadcom）于美国股市周四盘后公布了 2025 会计年度第二季（截至 2025 年 5 月 4 日为止）财报，不仅营收创下了 150.04 亿美元历史新高，AI 芯片营收也突破 44 亿美元，预计第三季 AI 芯片营收将增长至 51 亿美元。博通第二财季营收同比增长 20%至 150.04 亿美元，略高于市场预期的 149.6 亿美元，也创下了历史新高；依照美国一般公认会计原则（GAAP）净利润为 49.65 亿美元，同比暴涨 134%；Non-GAAP 净利润为 77.87 亿美元，同比大涨 44%；GAAP 摊薄后每股收益为 1.03 美元，同比暴涨 134%；Non-GAAP 摊薄后每股收益同比大涨 43.6%至 1.58 美元，也略高于市场预期的 1.57 美元。

从具体业务部门的表现来看，博通第二季半导体解决方案部门营收 84.08 亿美元，同比增长 17%；基础设施软件部门营收 65.96 亿美元，同比增长 25%。（来源：芯智讯）

台积电 2nm 良率已达 90%，美国厂将快速满产

6 月 3 日消息，据台媒报道，台积电美国亚利桑那州 4nm 晶圆厂已经量产，英伟达（NVIDIA）的 AI 芯片正在该晶圆厂进行工艺验证，预计将于今年年底进入量产。此外，苹果、AMD、高通、博通等美国客户也将会在该晶圆厂投产。这也将使得台积电美国 4nm 晶圆厂产能利用率快速满产，最大月产能可能会达到 24000 片。

有业内传闻称，由于客户对台积电亚利桑那州晶圆厂的产能需求旺盛，台积电计划对该晶圆厂的代工报价上调 30%，当然美国本土高昂的制造成本是推升价格上涨的最大因素。与此同时，台积电的 2nm 制程似乎也取得了长足的进步。据台媒报道，该公司凭借其尖端技术实现了超过 90% 的良率，不过目前的高良率适用于存储产品。（来源：芯智讯）

2025Q1 全球 DRAM 市场下滑 5.5%，SK 海力士以 36%份额位居第一

6 月 3 日消息，据市场研究机构 TrendForce 最新发布的调查报告显示，2025 年第一季因一般型 DRAM（conventional DRAM）合约价下跌，加上 HBM 出货规模收敛，DRAM 产业营收环比下滑 5.5%至 270.1 亿美元。平均销售单价方面，三星更改 HBM3e 产品设计，HBM 产能排挤效应减弱，使下游业者去化库存，导致多数 DRAM 产品合约价延续 2024 年第四季以来的下跌趋势。

从一季度各主要 DRAM 供应商营收表现来看，SK 海力士的 HBM3e 出货比重提升，支撑售价大致与上季持平，但是整体出货量较上季减少，导致整体营收环比下滑约

7.1%至 97.2 亿美元，市场份额维持在 36%，排名也上升至第一名。（来源：芯智讯）

机构下修 2025 年全球智能手机出货预测

6 月 5 日消息，据市场研究机构 Counterpoint Research 最新公布的《智能手机市场展望与出货预测报告》指出，受美国关税政策再现不确定性影响，将 2025 年全球智能手机出货年增长率预测由原先的 4.2%下修至 1.9%。尽管如此，除北美与中国大陆市场下滑，全球大多数地区仍预期将维持增长。

Counterpoint Research 副总监 Liz Lee 表示，市场高度关注苹果与三星的表现，因为他们对美国市场的依赖程度较高。本次预测下修除了反映关税影响，也考察了北美、欧洲及部分亚洲市场需求疲软的情况。

Liz Lee 进一步指出，Counterpoint Research 仍看好苹果 2025 年出货量维持正成长，主要是因为 iPhone 16 系列在 2025 年第一季度表现亮眼。此外，包括印度、东南亚及海湾阿拉伯国家（Gulf Cooperation Council, GCC）市场在内的新兴国家，持续展现高阶化趋势，将成为 iPhone 长期发展的有利条件。（来源：芯智讯）

意法半导体 CEO：芯片需求，正在复苏

意法半导体首席执行官表示，由于半导体需求回升，公司将达到本季度的预期。意法半导体第二季度营收约为 27.1 亿美元，同比下降逾 16%，但较第一季度增长 7.7%。其毛利率预计第二季度约为 33.4%，低于去年同期的 40.1%。首席执行官 Jean-Marc Chery 在法国巴黎银行主办的一场活动上表示，该公司将在第二季度至少实现预期中点，除非贸易紧张局势造成阻碍，否则需求复苏也将使第三季度受益。

意法半导体股价在巴黎上涨 10%，投资者对 Chery 的言论表示欢迎。Chery 表示，在经历了数月的低迷销售之后，市场对半导体的需求正在回升，尤其是用于电动汽车和工业设备的芯片。近几个季度以来，该行业一直在应对需求不均衡的问题。人工智能蓬勃发展，数据中心所需的半导体需求持续旺盛，但用于汽车和工业设备的芯片订单却一直疲软。这位高管表示，他认为第一季度是需求触底的时期。该公司第一季度销售额为 25.2 亿美元，同比下降逾 27%，净利润暴跌 89%，至 5600 万美元。（来源：半导体产业纵横）

搭载 2nm 工艺 A20 芯片！iPhone 18 Pro 系列首发

苹果产业链分析师 Jeff Pu 在最新报告中提到，iPhone 18 Pro 系列和苹果折叠屏机型将搭载 A20 芯片，这款芯片将首发台积电 2nm 制程工艺。

据了解，iPhone 16 Pro 系列采用第二代 3nm 工艺制程的 A18 Pro 芯片，而 iPhone 17 Pro 系列采用第三代 3nm 制程工艺的 A19 Pro 芯片，作为对比，iPhone 18 Pro 系列采用 2nm 制程工艺的 A20 芯片，其晶体管密度再度提升，预计对比 A19 芯片性能提升 15%，能效比提升 30%。

苹果将首次在其 iPhone 处理器中采用晶圆级多芯片模块 (WMCM) 封装。（来源：半导体产业纵横）

1Q25 淡季效应减轻，晶圆代工营收季减至 5.4%

根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2025 年第一季，全球晶圆代工产业受国际形势变化影响而提前备货，部分业者接获客户急单，加上中国延续 2024 年推出的旧换新补贴政策，抵消部分淡季冲击，整体产业营收季减约 5.4%，收敛至 364 亿美元。

展望第二季营收表现，整体动能逐步放缓，唯中国旧换新的补贴政策拉货潮有望延续，加上下半年智能手机新品上市前备货陆续启动，以及 AI HPC 需求稳定，将成为带动第二季产能利用率和出货的关键，预期前十大晶圆代工厂营收将呈现季增。（来源：TrendForce 集邦）

WSTS 预计全球半导体市场规模同比增长 11.2%

世界半导体贸易组织（WSTS）近日发布其 2025 年春季半导体市场最新预测。该机构认为，2025 年全球半导体市场规模将达到 7009 亿美元，同比增长 11.2%。按细分市场来看，今年的半导体市场规模攀升将由逻辑和存储器的增长引领：这两大市场均受到 AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动，同比涨幅将达到两位数；传感器和模拟等细分领域预计将做出积极贡献，尽管增长较为温和。WSTS 同时指出，尽管整体市场正在扩张，但预计部分产品细分市场将继续萎缩。例如，分立半导体、光电子器件和微型集成电路预计将出现较低个位数的下滑。这些下滑主要归因于持续的贸易紧张局势和负面的经济发展态势，这些因素扰乱了供应链，并抑制了特定应用领域的需求。从地区来看，美洲和亚太地区将引领增长，预计增长率分别为 18.0% 和 9.8%。相比之下，欧洲和日本预计将呈现温和增长。展望未来，WSTS 预测全球半导体市场到 2026 年将增长 8.5%，达到 7607 亿美元。增长将广泛存在于各个地区和产品类别中。预计存储器将再次引领增长，逻辑和模拟器件也将有所贡献。从地区来看，所有主要市场预计都将扩张，其中美洲和亚太地区将继续引领增长，而欧洲和日本预计将增强。（来源：集微网）

5. 风险提示

贸易摩擦加剧，需求复苏不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人独立研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处，不受任何第三方的影响和授意。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

申港证券股份有限公司（简称“本公司”）是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性和完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

申港证券研究所已力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，不构成其他投资标的的要约和邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。投资者不应单纯依靠本报告而取代自身独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载资料、意见及推测仅反映申港证券研究所于发布本报告当日的判断，本报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会产生波动，在不同时期，申港证券研究所可能会对相关的分析意见及推测做出更改。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者及风险承受能力为 C3、C4、C5 的普通投资者，本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户。本报告版权归本公司所有，未经事先许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如转载或引用，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、发布、转载和引用者承担。

投资评级说明

申港证券行业评级说明：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）

申港证券公司评级说明：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）